

UF 88UH 超快速固化黏合劑產品資料表

卓越的可靠性表現

優異的低溫固化性能

易於返工

簡介

UF 88UH是一種黏合劑，結合了數秒固化UV黏合劑的優點，以及毛細底部填充 (capillary underfill) 的低成本特性。該材料可在室溫下進行底部填充，無需對基板進行預熱。固化後，底部填充內部無空洞 (void-free)。固化後的UF 88UH可輕易返工移除。UF 88UH不僅可用於晶片級封裝 (CSP)、球柵陣列 (BGA)、封裝堆疊 (POP)、柵格陣列 (LGA) 以及部分覆晶 (flip-chip) 應用，同時也適用於多種先進封裝中的裸晶保護，例如記憶卡、晶片載體、混合電路以及多晶片模組。該材料專為高產能製程與友善製造環境設計，特別適用於對製程速度與抗機械衝擊性能要求較高的應用。其具有良好的可點膠性，可降低製程應力，並提供卓越的可靠性表現 (例如熱循環性能) 及優異的機械抗性。在跌落測試性能方面，相較於使用焊膏的方案，其性能提升可達兩個數量級。

物理特性

产品名称	UF 88UH 黏合劑
外觀 搭接剪切強度 (FR4/FR4)	粉紅色 / 紅色 2000 psi
表面電阻率 (MIL-STD-883E)	
項目	數值
比重 (ASTM D1475-60)	1.08 g/cc
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	4500-5000 cp
毛細流動速率 (STM 777)	室溫底部填充 (underfilling)
表面絕緣電阻 (J-STD-004)	通過
固化層材料性能	
玻璃化转变温度 Tg	79 °C
CTE (ASTM E 831) ppm/°C	α1 = 65; α2 = 182

推荐固化条件

在120°C条件下固化15–30分鐘。

注意：此固化時間不包括接合位置達到目標固化溫度所需的升溫時間。可評估使用其他替代固化曲線。

储存条件与保质期

在保持原始密封容器並存放於2–8°C條件下，保質期為3–6個月。超過此儲存期限可能會導致黏度升高。應避免接觸水分、揮發以及外來污染物。揮發或污染可能對材料的加工性能產生不良影響。

安全信息

UF 88UH 模封胶为环保型、无毒材料。但在操作和使用过程中，仍建议遵循一般的工业卫生规范。有关详细的安全信息，请参阅本产品的 安全数据表(SDS)。

包装规格

UF 88UH黏合劑提供10cc與30cc包裝規格。具体订购信息请联系 YINCAE。